

BOLIX ZP



Piana do przyklejania styropianu

Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach lub podłożach o nieznanymi właściwościach, należy wykonać próbę przyczepności. Należy przykleić w kilku miejscach na elewacji próbki styropianu o wym. 10x10x5 cm i ręcznym ich odrywaniu po min. 2 – 4 godzinach. Nośność podłoża jest wystarczająca, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W innym przypadku podłoże należy dostosować np. poprzez szlifowanie, usuwanie osłabionych warstw, gruntowanie i ponowne wykonanie próby przyczepności.

Podczas klejenia płyt styropianowych do podłoża ściennych należy zamocować listwy startowe, a w systemach izolacji fundamentów w celu uzyskania stabilnego podparcia dla klejonych płyt termoizolacyjnych, należy je wesprzeć na stopie fundamentowej, (jeśli to możliwe podeprzeć je w trakcie wiązania).

Przed ociepleniem budynków wielopłytowych zaleca się przeprowadzenie oceny stanu mocowania płyt fakturowych.

CECHY PRODUKTU:

- wysoka wydajność – do 10 m² z jednego kartusza w trakcie montażu płyt styropianowych do podłoża ściennych
- niskoprężny
- kołkowanie już po 2h
- możliwość prowadzenie prac przy temperaturze ≥ -5 °C
- doskonała przyczepność do podłoża mineralnych i płyt styropianowych EPS, w tym grafitowych oraz XPS
- bardzo dobra termoizolacyjność

PRZEZNACZENIE:

BOLIX ZP to niskoprężny, jednoskładnikowy klej poliuretanowy do przyklejania płyt styropianowych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych, a także do mocowania drugiej warstwy ocieplenia na ścianach już ocieplonych. Dedykowany również do ocieplania stref przyziemia i fundamentów płytami EPS-P oraz XPS.

Służy do:

- montażu:
 - płyt styropianowych EPS i XPS,
 - kasetonów styropianowych,
 - parapetów zewnętrznych,
- wypełniania szczelin w izolacji termicznej,
- sklejania płyt styropianowych.

Może być stosowany na podłożach:

- mineralnych (takich jak: beton, ściany murowane, tynki cementowe i cementowo-wapienne, itp.),
- drewnianych i drewnopochodnych,
- z PCV,
- hydroizolacjach asfaltowych i bitumicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

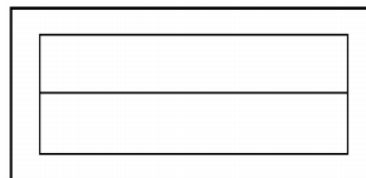
Podłoże powinno być: nośne, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych takich jak: kurz, tłuszcz, pyły, glony i innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku klejenia płyt styropianowych w niskich temperaturach z podłoża należy usunąć szron i oblodzenia. Podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) należy usunąć. Większe nierówności i ubytki wyrównać zaprawą BOLIX W lub BOLIX WB (podłoża betonowe).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:

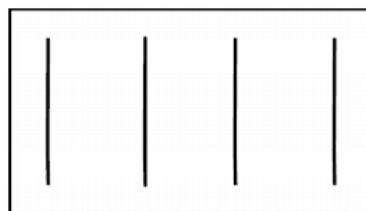
Puszka powinna mieć temperaturę dodatnią (optymalna +20°C). Pojemnik przez ok. 30 sekund intensywnie potrząsać, a następnie nakręcić do pistoletu aplikacyjnego (Uwaga! Zawór pistoletu powinien być zakręcony). Po przykręceniu otworzyć zawór i dozować w pozycji roboczej "do góry dnem" przez naciśnięcie spustu. Regulację strumienia dokonać poprzez ustawienie iglicy lub nacisk spustu pistoletu aplikacyjnego. W przypadku przerwy w nakładaniu powyżej 15 minut, pistolet aplikacyjny należy zabezpieczyć, pozostawiając nakręconą puszkę do kolejnego użycia.

ZASTOSOWANIE:

W przypadku klejenia płyt EPS i XPS powyżej fundamentów, piankę należy nakładać na płytę styropianową warkoczem o średnicy około 3 cm, po obwodzie płyty z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi i jednym pasem przez środek szerokości płyty.



Podczas klejenia płyt termoizolacyjnych do powierzchni fundamentów i podziemnych części budynków / budowli pokrytych hydroizolacją asfaltową lub bitumiczną, klej poliuretanowy należy nakładać na płytę przy użyciu pistoletu czterema pionowymi pasmami o szerokości ok. 3 cm z zachowaniem równych odstępów co 20 ÷ 30 cm i zachowaniem dystansu 3 cm od krawędzi płyty. (w przypadku płyt o szerokości powyżej 100 cm, należy nałożyć na powierzchnię płyty większą ilość warkoczki kleju).



Po nałożeniu kleju w obu przypadkach należy odczekać około 5 minut (w temp +20°C) lub 7-8 minut (w temp. -5 °C), a następnie przyłożyć do



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX ZP

Piana do przyklejania styropianu

ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć łatą aż do uzyskania równej powierzchni z płytami wcześniej przyklejonymi. Nie przekraczać czasu naskórkowania! Możliwa jest korekta położenia płyty względem podłoża w czasie do 10 - 15 min. od jej przyklejenia.

Po upływie około 2 godzin płyty są gotowe do dalszej obróbki (szlifowanie i kotkowanie). Płyty termoizolacyjne powyżej fundamentów należy obowiązkowo mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych, zgodnie z projektem technicznym ocieplenia.

Przy fundamentach oraz obszarach podziemnych termoizolacji nie należy kotkować aby nie uszkodzić hydroizolacji. Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych musi być równa i ciągła. Szczeliny między płytami na całej grubości ocieplenia należy wypełnić styropianem lub niskorosprężną pianką poliuretanową BOLIX PM-L lub BOLIX ZP.

Styropian przyklejać z zachowaniem mijankowego układu płyt.

UWAGI I ZALECENIA REALIZACYJNE:

- Przed przystąpieniem do prac, elementy takie jak okna, drzwi, parapety należy odpowiednio ostonić i zabezpieczyć.
- Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne należy sezonować minimum 28 dni.
- Wyznaczyć powierzchnię przeznaczoną do ocieplenia uwzględniając warunki pogodowe, rodzaj podłoża i możliwości wykonawcze.
- Przed przyklejeniem termoizolacji należy zidentyfikować wszystkie instalacje biegnące po elewacji lub w jej pobliżu, aby nie uszkodzić ich podczas mocowania mechanicznego ociepleń (wiercenie otworów).
- W czasie nakładania i dojrzewania pianki, powierzchnie chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru. Stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.
- Wskutek oddziaływania promieni słonecznych styropian grafitowy ulega szybkiemu nagrzewaniu, co może spowodować odkształcenia i/lub deformację płyt styropianowych. Dlatego też zaleca się zastosowanie emulsji BOLIX PTE ograniczającej absorpcję promieniowania cieplnego przez materiał termoizolacyjny, tym samym znacznie ograniczając jego odkształcenia termiczne.
- Niska temperatura, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydłużają czas wysychania i dojrzewania pianki klejącej.
- Wysoka wilgotność powietrza i podłoża powoduje przyspieszenie wiązania pianki poliuretanowej.
- Pianka nie przylega do silikonu, teflonu, polietylenu, polipropylenu i poliamidu.
- Po zakończeniu prac pistolet aplikacyjny przeczyszczyć. Zaleca się stosowanie czyszcika do pian poliuretanowych BOLIX CP lub acetonem, stwardniały klej usunąć mechanicznie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I PRZECHOWYWANIE:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej (aby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze od +5 do +35 °C (zalecana temperatura pokojowa) chroniąc od bezpośredniego nasłonecznienia lub innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące.

Wyrób zawiera izocyjaniany. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta, warunkami bezpiecznego stosowania wyrobu umieszczonymi na opakowaniu i niniejszej karcie technicznej. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem

i nagrzaniem powyżej temperatury +50°C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu -nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią. Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcję alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno-skórno. Produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania i zagrożeń stwarzanych przez produkt zawarte są w Karcie Charakterystyki.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA:

- Pistolet do pianki

DANE TECHNICZNE:

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie nakładania i dojrzewania:
od -5°C do +30°C

Gęstość PN-EN ISO 845:
ok. 15 (±10 %) kg/m³

Barwa:
jasnożółta

Formuła:
niskopiętna

Struktura:
jednorodna, drobnokomórkowa

Czas naskórkowania:
7÷14 min. (temp. +20°C i 90% wilgotności względnej powietrza)

Czas dojrzewania przed dalszą obróbką:
≥ 2h (temp. +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza)

Czas pełnego utwardzenia:
≥ 24h

Wsp. przewodzenia ciepła:
≤ 0,04 W/(m*K)

Odporność termiczna po utwardzeniu:
-50°C ÷ +90°C

Stabilność wymiarów:
2% (przy 40°C i 95% wilgotności względnej powietrza po 24h)

Klasa palności wg normy DIN 4102:
B3

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym kleju swobodnie spienionego wg PN-EN 826:
≥ 40 kPa

Oddziaływanie kleju na styropian w temp. +23°C i +75°C:
brak oznak destrukcji styropianu; powierzchnia nienaruszona

Klasa palności:
B3 wg normy DIN 4102

Rozpuszczalność preparatu:
przed utwardzeniem ulega rozpuszczeniu w rozpuszczalnikach organicznych tj. aceton

Wytrzymałość na rozciąganie (połączenie EPS-podłoże) wg PN-EN 1607:1999, MPa:
≥ 0,157 beton ; ≥ 0,105 bloczek ceramiczny

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX ZP

Piana do przyklejania styropianu

Wytrzymałość na rozciąganie (połączenie XPS-podłoże) wg PN-EN 1607:1999, MPa:

≥ 0,270 beton

≥ 0,150 bloczek ceramiczny

Przyczepność do podłoża z powłoką bitumiczną, MPa:

≥ 0,270 w warunkach mokrych

≥ 0,220 w warunkach suchych

≥ 0,210 w temp pow. +30°C

Przyczepność do styropianu EPS / XPS, MPa:

≥ 0,08

Opakowania:

kartusz 750 ml

Ilość opakowań w kartonie i waga netto produktu:

12 / ok. 11kg

Okres przydatności do stosowania:

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ OPAKOWANIA:

- ocieplenia powyżej fundamentów – ok. **10 ÷ 12 m²**
- ocieplenia fundamentów i przyziemia – ok. **14 m²**

przy aplikacji warkoczem o wymiarach średnicy 3 cm, wysokości 2,5 cm. Zużycie pianki klejącej jest uzależniona m.in. od temperatury i wilgotności otoczenia oraz podłoża.

W celu dokładnego określenia zużycia wyrobu zaleca się przeprowadzenie prób na danym podłożu.

SKŁAD:

Diizocyanian 4,4'-metylenodifenylu, gaz pędny mieszanina skroplona pod ciśnieniem zawierająca propan-butan-izobutan

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

**Masz pytania?**Zadzwoń!
801-650-222Napisz!
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl**BOLIX®**